

助焊剂的沉积与验证

正确的助焊剂沉积与验证工艺

- ★ 确保校准了PCB电子秤。
- 确定称重袋和不含助焊剂的电路板初始重量。
- 通过助焊剂应用工艺涂覆裸板。
- 从传送带上小心的移除带助焊剂的电路板，并将其装入称量袋中。
- 确定称量袋和带助焊剂的电路板重量后，并用以下公式计算：

如何计算助焊剂使用量

PCB 焊盘面积 = 长 x 宽

$$\text{使用的助焊剂重量} = \frac{(\text{最终重量} - \text{初始重量})}{\text{PCB 焊盘面积}}$$

如需下载或了解更多信息，请访问

www.aimsolder.com



Solder plus Support